

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年12月1日(01.12.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/249888 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) C09J 7/38 (2018.01)
B32B 27/00 (2006.01) C09J 133/00 (2006.01)
C09J 7/29 (2018.01) H01L 21/683 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/019981

(22) 国際出願日: 2022年5月11日(11.05.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-088684 2021年5月26日(26.05.2021) JP

(71) 出願人: 株式会社 ディスコ (DISCO CORPORATION) [JP/JP]; 〒1438580 東京都大田区大森北二丁目13番11号 Tokyo (JP). デンカ株式会社 (DENKA COMPANY LIMITED) [JP/JP]; 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 本池 進悟 (MOTOIKE, Shingo); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP). 飯塚 一樹 (IIZUKA, Kazuki); 〒1038338 東京都中

央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP). 中村 将 (NAKAMURA, Masashi); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP). 蓮見 水貴 (HASUMI, Mizuki); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP).

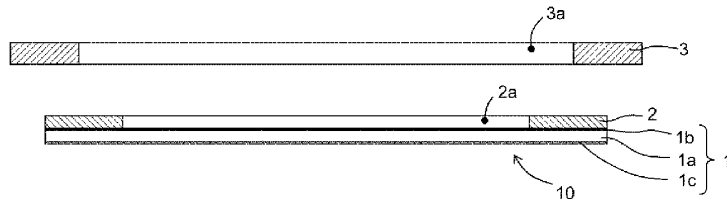
(74) 代理人: S K 特許業務法人, 外 (SK INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM et al.); 〒1500012 東京都渋谷区広尾3-12-40 広尾ビル4階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,

(54) Title: ADHESIVE SHEET FOR REAR SURFACE GRINDING, SEMICONDUCTOR WAFER MANUFACTURING METHOD, AND BASE MATERIAL SHEET

(54) 発明の名称: 裏面研削用粘着シート及び半導体ウエハの製造方法、基材シート

図1



(57) Abstract: Provided is an adhesive sheet for rear surface grinding with which an adhesive layer is prevented from peeling off and a wafer can be easily peeled off from the adhesive sheet. According to the present invention, this adhesive sheet for rear surface grinding of a semiconductor wafer having a protrusion comprises a base material layer, and an adhesive layer provided on the base material layer, wherein: the adhesive layer has an opening that is smaller in diameter than the semiconductor wafer and is affixed to the outer periphery of the semiconductor wafer such that the protrusion of the semiconductor wafer is disposed inside the opening; the protrusion is protected by the base material layer in a state in which the semiconductor wafer is affixed to the adhesive layer; the base material layer includes a cushion layer and a surface treatment layer provided thereon; the adhesive layer is provided on the surface treatment layer; the surface treatment layer is formed from an acrylic resin composition containing an acrylic resin; the acrylic resin is crosslinked by photoirradiation or heating; and the adhesive layer is formed from the acrylic resin composition containing an acrylic resin.

WO 2022/249888 A1

[続葉有]

SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT,
TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(57) 要約: 粘着剤層の剥がれが抑制され、且つウエハを粘着シートから容易に剥がすことができる、裏面研削用粘着シートを提供する。本発明によれば、凸部を有する半導体ウエハの裏面研削用粘着シートであって、基材層と、前記基材層上に設けられた粘着剤層と、を備え、前記粘着剤層は、前記半導体ウエハの直径よりも小径の開口部を有し、前記半導体ウエハの凸部が前記開口部内に配置されるように前記半導体ウエハの外周部に貼着され、前記半導体ウエハが前記粘着剤層に貼着された状態で前記凸部が前記基材層によって保護されるように構成され、前記基材層は、クッション層とその上に設けられた表面処理層を備え、前記粘着剤層は、前記表面処理層上に設けられ、前記表面処理層は、アクリル系樹脂を含むアクリル系樹脂組成物で形成され、前記アクリル系樹脂が光照射又は加熱により架橋されており、前記粘着剤層は、アクリル系樹脂を含むアクリル系樹脂組成物で形成されている、粘着シートが提供される。